

技術詞彙表

本技術詞彙表載有本文件所用與本公司及我們業務有關的若干技術詞彙的解釋。該等術語及含義可能有別於其標準行業含義或用法。

「年複合增長率」	指	年複合增長率
「雲端訓練」	指	利用雲計算平台的強大算力(如數據中心的服務器和GPU集群)來訓練人工智能模型的訓練方式
「主控芯片」	指	專業化微處理器，為閃存介質提供驅動和高速數據傳輸，具有特定的外部接口和協議處理模塊，負責與主機通信，決定存儲產品的形式和類別
「現金產生單位」	指	現金產生單位
「CPU」	指	中央處理器，用作電子產品計算和控制核心的集成電路
「DDR」	指	雙倍數據傳輸速率，是JEDEC就SDRAM產品制定的行業通行參數標準
「顆粒」	指	從半導體晶圓中切割下來的單個集成電路
「內存條」	指	內存條，一種雙列直插存儲模組，其特點是具有一系列的安裝在印刷電路板上的DRAM集成電路，兩面設有電氣觸點，用於連接設備主板，為數據處理提供易失性存儲。內存條的主要類型包括帶寄存器的內存條(「RDIMM」)、小外形內存條(「SODIMM」)及無緩存器的內存條(「UDIMM」)，每種類型均為滿足各種計算環境的特定性能及外形尺寸要求而設計
「DRAM」	指	動態隨機存取存儲器，計算機和其他設備用於存儲正在主動使用或處理的數據的易失性存儲器，需要定期刷新以維護所存儲的信息

技術詞彙表

「邊緣計算」	指	把計算和數據處理能力放在靠近數據源頭的設備(如手機、傳感器、車載終端等)側，而不是完全依賴遠程雲服務器的計算方式
「嵌入式存儲」	指	集成到電子產品主系統中的存儲產品，其採用大容量嵌入式的NAND Flash解決方案或DRAM解決方案或NAND及DRAM複合解決方案，主要用於智能手機和平板電腦等設備
「eMCP」	指	嵌入式多芯片封裝，一種將eMMC及LPDDR封裝在一個封裝內的半導體封裝技術，最大限度地減少空間和增強芯片之間的連接性，同時可以增強功能和性能
「eMMC」	指	嵌入式多媒體存儲器，一種由閃存和閃存控制器組成的集成式非易失性存儲系統，主要用於便攜式設備進行可靠高效的數據存儲和管理
「ePoP」	指	嵌入式堆疊封裝，一種半導體封裝技術，eMMC及LPDDR集成在一個封裝內，並直接堆疊在CPU表面之上
「固件」	指	內存中預裝的程序代碼，在閃存控制器內運行，負責存儲器中的協議處理、數據管理和硬件驅動等核心任務
「閃存」	指	一種非易失性半導體存儲器芯片，即使在電源關閉的情況下也能保留存儲的信息，其特點是可以反覆讀取、擦除和寫入
「FTL」	指	閃存印射層，一種構建於原始閃存之上的軟件層，負責執行垃圾回收和磨損均衡策略，並通過模擬類似磁盤的普通塊設備，具有向上層文件系統屏蔽閃存的特殊特性

技術詞彙表

「HBM」	指	高帶寬內存，一種用於高性能計算和圖形應用的內存
「IDM」	指	存儲產品原廠，指設計、製造及銷售自有產品的公司，處理從設計、製造到分銷的整個生產流程，而就半導體行業而言，指涵蓋芯片設計、晶圓製造及封裝測試等全部業務環節的企業
「集成電路」或「IC」	指	一種微型電子設備或元件，採用半導體技術製造，將電路所需的所有晶體管、電阻器、電容器、電感器及其連接線集成到一個小的半導體芯片（如硅芯片或基板）上，然後焊接並封裝在外殼內，形成一個具有所需電路功能的電子設備
「IoT」	指	物聯網，相互通信和交換數據的互聯設備網絡
「JEDEC」	指	聯合電子設備工程委員會或固態技術協會，為固態和半導體行業的標準化機構，負責制定固態電子產品的行業標準
「LLM」	指	大型語言模型，一種基於海量文本數據訓練的人工智能模型，具備理解和生成人類語言的能力
「LPDDR」	指	低功耗雙倍數據速率，JEDEC推出的低功耗SDRAM產品的行業標準
「多芯片封裝」	指	多芯片封裝，一種半導體封裝技術，通過堆疊等方法將兩個或多個存儲芯片封裝在一個封裝體內
「NAND Flash」	指	一種非易失性閃存技術和基於該技術的產品，通常用於數據存儲
「NOR閃存」	指	一種非易失性閃存技術和基於該技術的產品，通常用於數據存儲，通常用於代碼存儲
「OEM」	指	原始設備製造商，利用自身品牌優勢、核心技術和銷售渠道，委託有生產能力的製造商生產產品，然後向市場銷售的公司

技術詞彙表

「端側AI」	指	在終端設備上直接進行人工智能計算和處理的技術，而不是依賴遠程服務器或雲端
「PCB」	指	印製電路板，在電子設備中使用從層壓在非導電基板上的銅片蝕刻而成的導電通路、軌道或信號跡線連接電子元件的電路板
「PCIe」	指	外圍元件互連快線，一種高速接口標準，用於將各種硬件元件連接到計算機主板，提供快速數據傳輸並提高性能，包括Gen1至Gen5等不同代
「RAM」	指	隨機存取存儲器，一種可隨機存取的計算機存儲器，用於存儲工作數據和當前使用的機器代碼，允許快速讀寫訪問
「ROM」	指	只讀存儲器，一種非易失性存儲器，在計算機和其他電子設備中用於存儲並非旨在頻繁修改的固件或軟件
「SATA」	指	串行高級技術附加裝置，一種使用串行連接的接口標準，廣泛用於將硬盤和固態硬盤等存儲設備連接到計算機主板，便於數據傳輸
「SRAM」	指	靜態隨機存取存儲器，一種使用雙穩態鎖存電路存儲每個位的RAM，其存取時間比DRAM更快，且毋須定期刷新
「半導體存儲產品」	指	具有信息存力的半導體組件，作為數據或程序的硬件介質廣泛應用於各種電子產品中
「SiP」	指	系統級封裝，一種芯片封裝技術，該技術可將多個電子元件（如處理器、存儲器和傳感器、無源元件以及其他電子元件）集成到一個封裝中，讓緊湊型電子設備可以高度集成，提高設計靈活性，同時減少佔用空間

技術詞彙表

「固態硬盤」	指	固態硬盤，一種安裝在計算機或服務器中的內部存儲組件，與傳統硬盤驅動器相比，性能更強，可靠性更高
「SoC平台」	指	一種將CPU、GPU、內存和通信模塊等核心部件集成在單一芯片上的平台。其具有體積小、功耗低、效率高的特點，常用於智能手機、物聯網設備、車載系統和工業設備
「TB」	指	太字節，數字信息存儲單位，約等於一萬億個字節
「UFS」	指	通用閃存，一種高性能、可擴展的閃存存儲規格，旨在用於移動設備和消費電子產品，可提供快速的數據傳輸速度和更高的能效
「uMCP」	指	基於UFS的多製層封裝芯片，一種在單個封裝內集成UFS及LPDDR的半導體封裝技術，旨在通過支持各種功能和互連，實現通用性和適應性，以滿足各種應用的需要
「USB」	指	通用串行總線，一種可實現計算機與外圍設備之間通信和供電的標準接口，便於各種電子設備之間進行連接和數據傳輸
「VR」	指	虛擬現實，一種創建模擬的、身臨其境的環境的技術
「晶圓供應商」	指	設計、製造和供應存儲晶圓的公司